

## 様式第二十一（第13条関係）

### 認定事業再編計画の内容の公表

1. 認定をした年月日  
令和5年1月18日

2. 認定事業者名  
濱田重工株式会社

3. 事業再編計画の目標  
(1) 事業再編に係る事業の目標

（価値観）

濱田重工株式会社（以下、当社）は1898年に官営八幡製鉄所の工事を請け負って以来、一世紀を超える長きにわたって鉄鋼関連事業に携わってきた。さらに近年では半導体用シリコンウェハの再生加工分野にも進出しており、エンジニアリング事業を含めたこれらの3事業を事業の柱としている。

当社は創業当初より、「誠心（まごころ）」を企業理念として掲げ、あらゆる課題に真摯に向き合い、既存の枠に捉われない柔軟な発想と先端技術で解決策を提供することでモノづくりの未来を支え、多くの人が幸せを享受できる社会の実現を目指している。

（ビジネスモデル）

半導体事業に関しては、近年社会のデジタル化が進行し、今後一層加速していくと考えられることや、目下では当社の半導体事業地の近隣に半導体の受託生産で世界最大手の台湾TSMC社が進出するなど、その経営環境が急激に変化している状況である。

そこで、当社の主要3事業の中で経営環境が唯一異なる半導体事業を分社化することにより、機動的な事業展開、最適な経営資源の配分や必要な人材の確保を推し進め、グループとしてこれまで以上の価値創造を実現することを目的とする。

（戦略）

経営環境の変化が比較的少ない鉄鋼関連事業やエンジニアリング事業とは異なり、半導体事業については前述の通り、近年経営環境の変動が著しいことから、半導体事業について環境変化に耐えられる組織とすることが喫緊の課題となっていた。

そこで、事業再編により当社の半導体事業を分社化し、その事業展開に適した会社組織を生成することで機動的かつ効果的な事業運営を行っていく。また、脱炭素化社会への機運の高まりから今後も旺盛な需要が見込まれるパワー半導体材料の加工について、分社化を機に、これまでの研究開発段階から事業化へと歩を進める。

（持続可能性・成長性）

今後も将来にわたって成長が見込まれる半導体事業に関して、柔軟な経営環境の創出を行うと共に、これから成長が見込まれる素材・分野・領域での新たな取り組みを行っていくことで、当社グループの持続的な成長を図っていく。

（ガバナンス）

上記に掲げた事業再編計画の実施に当たり、分割承継会社であるハマダレクテック株式会社にて行われる半導体事業の執行について、当社がグループ経営資源の最適配分の観点から適切に監督を行い、事業再編計画の進捗状況を適時適切にモニタリングできる体制の構築に努める。

以上より、当社の経営資源の最適配置によって生産性の向上並びに付加価値創出を図り、企業価値の更なる向上を目指す。

(2) 生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標

(成果と重要な成果指標(KPI))

計画の対象となる事業の生産性の向上としては、2025年度には2022年度に比べて、従業員1人当たり付加価値額を6.7%向上させることを目標とする。

財務内容の健全性の向上としては、2025年度において濱田重工株式会社及びハマダレクテック株式会社の有利子負債はキャッシュフローの▲4.3倍、経常収支比率は115%となる予定である。

4. 事業再編の内容

(1) 事業再編に係る事業の内容

① 計画の対象となる事業  
半導体事業

<選定の理由>

半導体事業は当社の収益の柱の1つであるが、近年、社会のデジタル化の進行や当社近隣地への台湾TSMC社の進出など、その経営環境が急激に変化している状況である。

そのような背景の下、分社化による事業組織の最適化、経営資源の最適配分により変化に対応できる事業基盤を確立すると共に、着実な必要人員確保等を押し進めることにより、既存事業の維持・強化を図り、同時に新たな事業領域にも挑戦していくことが当社グループの企業価値向上のために必須であるものと考え、対象事業として選定した。

② 実施する事業の構造の変更と分野又は方式の変更の内容

当社の半導体事業を新設分割によりハマダレクテック株式会社に移管する。これに伴い、既存のシリコンウェハー再生加工等で培われた経営資源をフル活用し、研究開発に留まっていたパワー半導体材料加工の事業化を推進し、新たな事業領域の創出を目指す。

なお、当該事業再編計画による生産性の向上は当該事業分野における市場構造に照らしても持続的なものと見込まれる。

また、当該事業分野は世界的に未だ市場形成途上にあり、日本国内における市場形成にも寄与するものと考えており、過剰供給構造にはなく、さらに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものではない。

(事業の構造の変更)

- ・半導体事業の承継（株式を対価とする新設型の分社型分割）

<分割会社>

名称：濱田重工株式会社

住所：福岡県北九州市戸畑区牧山1丁目1番36号

代表者の氏名：松本 豊

資本金：326百万円

<承継会社>

名称：ハマダレクテック株式会社

住所：熊本県菊池郡大津町高尾野272-8

代表者の氏名：永田 竜也

分割前の資本金：なし（新設分割であるため）  
分割後の資本金：301百万円  
発行する株式を引き受ける者：濱田重工株式会社  
分割予定日：2023年2月1日

（事業の分野又は方式の変更）

会社分割を行うことにより、半導体事業の急激な事業環境の変化に対応するため、的確な経営判断と迅速な意思決定を行うことができる機動的な事業組織の構築を行うと共に、半導体人材の確保に向けた人事制度の変革を行う。これによって新規販売先の開拓や人材の確保を図り、さらには設備投資を複合的に推し進めていくことで、パワー半導体材料の加工品の量産化を進め、事業として新たに展開することを考えている。2025年度にはパワー半導体材料の加工品の売上を全売上の1%以上とすることを目標とする。

(2) 事業再編を行う場所の住所

住所：福岡県北九州市戸畑区牧山1丁目1番36号  
名称：濱田重工株式会社

住所：熊本県菊池郡大津町高尾野272-8  
名称：ハマダレクテック株式会社

(3) 関係事業者・外国関係法人に関する事項

ハマダレクテック株式会社  
（熊本県菊池郡大津町高尾野272-8）

(4) 事業再編を実施するための措置の内容

別表1のとおり

5. 事業再編の実施時期

事業再編の開始時期及び終了時期

開始時期：2023年2月

終了時期：2025年7月

6. その他

該当なし

別表 1

事業再編の措置の内容

措置事項	実施する措置の内容及びその実施する時期	期待する支援措置
法第2条第17項第1号の要件		
ロ 会社の分割	<p>①分割会社 住所：福岡県北九州市戸畑区牧山1丁目1番36号 名称：濱田重工株式会社 代表者の氏名：松本 豊 資本金：326百万円</p> <p>②分割承継会社 住所：熊本県菊池郡大津町高尾野272-8 名称：ハマダレクテック株式会社 代表者の氏名：永田 竜也 資本金：301百万円</p> <p>③発行する株式を引き受ける者： 濱田重工株式会社</p> <p>④分割予定日：2023年2月1日</p>	<p>租税特別措置法第80条第1項第3号（会社分割に伴う株式会社の設立の登記等の税率の軽減）、同第6号（会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減）</p>
法第2条第17項第2号の要件		
イ 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供による生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成の変化	<p>会社分割を行うことにより、半導体事業の急激な事業環境の変化に対応するため、的確な経営判断と迅速な意思決定を行うことができる機動的な事業組織の構築を行うと共に、半導体人材の確保に向けた人事制度の変革を行う。これによって新規販売先の開拓や人材の確保を図り、さらには設備投資を複合的に推し進めていくことで、パワー半導体材料の加工品の量産化を進め、事業として新たに展開することを考えている。2025年度にはパワー半導体材料の加工品の売上を全売上の1%以上とすることを目標とする。</p>	